

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гриднев В.Н., Гриднева Г.Н.* Проектирование коммутационных структур электронных средств – М. : Издательство МВТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 344 с.
2. *Гриднев В. Н.* Методические указания к домашнему заданию по курсу ТПС и ТП ЭВА / Под ред. О. Д. Парфенова. – М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1981. – 32 с.
3. *Ивченко В. Г.* Конструирование и технология ЭВМ : конспект лекций. – Таганрог, 2001.
4. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры : учебник для вузов / Под общ. ред. В. А. Шахнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 568 с.
5. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры : учебник для вузов / К. И. Билибин, А. И. Власов и др.; Под общ. ред. В. А. Шахнова. – М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 528 с.
6. *Медведев А.* Печатные платы. Конструкции и материалы. – М. : Техносфера, 2005. – 304 с.
7. *Пирогова Е. В.* Проектирование и технология печатных плат : учебник. – М. : Форум, ИНФРА-М, 2005. – 560 с.
8. *Стерлинг Дж. Дж.* Волоконная оптика. Техническое руководство. – М. : Издательство «ЛЮРИ», 2001. – 288 с.
9. Технологии в производстве электроники. Часть I. Справочник по производству печатных плат / Под ред. П. Семенова. – М. : ООО Группа ИТД, 2007. – 586 с.
10. *Туник В. А.* Технология и организация производства радиоэлектронной аппаратуры : учебное пособие. – СПб. : Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004. – 144 с.
11. *Гриднев В.Н., Кондаков Н.А., Трошина Д.П., Фатхутдинов Т.М.* Анализ проектирования многослойных печатных плат // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". 2018. Т. 2. С. 139-142.
12. *Резчикова Е.В., Соловьев В.А., Долуханян А.М., Жукова А.А.* Морфологический подход к анализу многослойных печатных плат со встроенными компонентами // Технологии инженерных и информационных систем. 2020. № 1. С. 71-82.
13. *Гриднев В.Н., Емельянов Е.И., Власов А.И., Леонидов В.В.* Методика автоматизированного проектирования электронных коммутационных структур в среде ALTIUMDESIGNER // Датчики и системы. 2016. № 5 (203). С. 28-36.
14. *Гриднев В.Н., Емельянов Е.И., Власов А.И., Карпунин А.А.* Методика автоматизированного проектирования электронных коммутационных структур в среде ALTIUM DESIGNER: Управление проектом // Датчики и системы. 2016. № 6 (204). С. 46-52.

15. *Гриднев В.Н., Григорьев П.В., Емельянов Е.И., Камышная Э.Н.* Методика автоматизированного проектирования электронных коммутационных структур в среде ALTIUM DESIGNER: Разработка библиотеки посадочных мест // Датчики и системы. 2016. № 7 (205). С. 33-41.
16. *Арабов Д.И., Гриднев В.Н., Емельянов Е.И., Леонидов В.В.* Методика автоматизированного проектирования электронных коммутационных структур в среде ALTIUMDESIGNER: Разработка библиотеки компонентов // Датчики и системы. 2016. № 8-9 (206). С. 42-51.
17. *Власов А.И., Гриднев В.Н., Жалнин В.П., Емельянов Е.И.* Методика автоматизированного проектирования электронных коммутационных структур в среде ALTIUMDESIGNER: Схемотехническое проектирование // Датчики и системы. 2016. № 10 (207). С. 37-45.
18. *Власов А.И., Гриднев В.Н., Жалнин В.П., Емельянов Е.И.* Методика автоматизированного проектирования электронных коммутационных структур в среде ALTIUMDESIGNER: Топологическое проектирование // Датчики и системы. 2016. №11 (208). С. 28-39.
19. *Власов А.И., Гриднев В.Н., Жалнин В.П., Емельянов Е.И.* Методика автоматизированного проектирования электронных коммутационных структур в среде ALTIUMDESIGNER: Синтез проекта коммутационной структуры // Датчики и системы. 2016. № 12 (209). С. 34-45.
20. *Гриднев В.Н., Миронова Ж.А., Шахнов В.А.* Обеспечение качества компоновки монтажных контактных площадок высокоплотной коммутационной платы // Надежность и качество сложных систем. 2014. № 4 (8). С. 19-25.
21. *Билибин К. И., Гриднев В. Н.* Проектирование маршрутных и операционных технологических процессов в технологии приборостроения. – М. : Издательство МВТУ им. Н. Э. Баумана, 1987.
22. *Миронова Ж.А., Шахнов В.А., Гриднев В.Н.* Высокоплотная компоновка проводящего рисунка многослойных коммутационных плат // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение. 2014. № 6 (99). С. 61-70.
23. *Власов А.И., Гриднев В.Н., Константинов П., Юдин А.В.* Нейросетевые методы дефектоскопии печатных плат // Электронные компоненты. 2004. № 8. С. 148-155.
24. *Гриднев В.Н., Емельянов Е.И.* Монтаж микросхем в корпусах BGA в электронные модули пространственной компоновки // Проектирование и технология электронных средств. 2014. № 3. С. 41-47.
25. *Власов А.И., Гриднев В.Н., Милешин С.А., Козлова А.Ю.* Маршрут технологической подготовки производства печатных плат в среде САМ350 // Технологии инженерных и информационных систем. 2017. № 1. С. 14-45.
26. *Гриднев В.Н., Жалнин В.П., Козлова А.Ю.* Комплексная методика автоматизированного технологического проектирования в среде САМ350 // Информационные технологии в проектировании и производстве. 2017. № 2 (166). С. 55-66.

27. *Зимин Д.В., Гриднев В.Н.* Обеспечение качества проектирования многослойных печатных плат при конструировании вч-устройств // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". 2017. Т. 2. С. 183-186.
28. *Преснухин Л.Н., Шахнов В.А.* Конструирование электронных вычислительных машин и систем. —М.: Высшая школа, 1986.
29. *Александров К.К., Кузьмина Е.Г.* Электротехнические чертежи и схемы. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 288 с.
30. *Норенков И. П.* Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. — 430 с.
31. *Глушко А.В., Кузьмина Н.В., Савенков И.И.* Анализ систем автоматизированного проектирования печатных плат // Технологии инженерных и информационных систем. 2020. № 4. С. 64-76.
32. *Сергеева М.Д., Кузьмина С.В., Борисов Г.М.* Анализ систем автоматизированного проектирования печатных плат // Технологии инженерных и информационных систем. 2021. № 1. С. 59-71.
33. *Арабов Д.И., Власов А.И., Гриднев В.Н., Григорьев П.В.* Концепция цифрового инструментального производства (FAB LAB) для прототипирования изделий электронной техники // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 5-3 (47). С. 23-34.
34. *Арабов Д.И., Верясова А.Ю., Гриднев В.Н.* Комплексное макетирование узлов вычислительной техники с использованием инфраструктуры цифрового производства (FAB-LAB) в условиях сквозного обеспечения качества // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2016. № 1. С. 189-192.
35. *Власов А.И., Завьялов Н.В., Селиванов К.В., Скальченков И.И.* Применение нейронных сетей в обнаружении дефектов печатных плат // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2022. Т. 24. № 6. С. 5-19.
36. *Аверьянихин А.Е., Власов А.И., Евдокимова Е.В.* Иерархическая пирамидальная субдискретизация в глубоких сверточных сетях для распознавания визуальных образов // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2021. Т. 23. № 1. С. 17-31.
37. *Верясова А.Ю., Власов А.И., Гладких А.А.* Нейросетевые методы дефектоскопии интегральных структур // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2019. № 2. С. 54-67.
38. *Власов А.И., Гриднев В.Н., Константинов П., Юдин А.В.* Нейросетевые методы дефектоскопии печатных плат // Электронные компоненты. 2004. №8. С. 148-155.
39. *Макушина Н.В., Сергеева М.Д.* Анализ дефектов металлизированных отверстий печатных плат // Проектирование и технология электронных средств. 2018. № 1. С. 3-12.
40. *Макушина Н.В., Сергеева М.Д.* Методика контроля качества металлизированных отверстий печатных плат на микрошлифах // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". 2018. Т. 2. С. 44-48.

41. *Панфилова С.П., Власов А.И., Гриднев В.Н., Червинский А.С.* Бесконтактный тепловой контроль электронно-вычислительных средств // *Технология и конструирование в электронной аппаратуре.* 2007. № 6 (72). С. 42-49.
42. *Панфилова С.П., Власов А.И., Гриднев В.Н., Червинский А.С.* Бесконтактный тепловой контроль изделий электронной техники // *Производство электроники.* 2007. № 3. С. 25-30.
42. *Гриднев В.Н., Сергеева М.Д., Чебова А.И.* Линейные модели распознавания тепловизионных изображений неисправностей электронных ячеек // *Контроль. Диагностика.* 2014. № 8. С. 57-66.
43. *Селиванов К.В., Долотов И.И., Домников А.С.* Выбор конструкционных материалов и приемов для эффективного отвода тепла от печатных плат // *Технологии инженерных и информационных систем.* 2023. № 1. С. 3-11.
44. *Аминов Д.А., Захаров Е.Р., Семенякина В.О., Бортник Б.Ю.* Особенности применения технологии обратного высверливания при создании печатных плат // *Технологии инженерных и информационных систем.* 2018. № 4. С. 27-35.
45. *Гордеев Д.В., Зайкин В.А., Селиванов К.В., Цветков А.А.* Анализ материалов для изготовления печатных плат // *Технологии инженерных и информационных систем.* 2020. № 3. С. 26-45.
46. *Назаров А.В., Смирнов К.К., Лягин И.В.* Автоматизация проектирования электрической оснастки для функционального контроля сверхбольших интегральных схем // *Технологии инженерных и информационных систем.* 2023. № 1. С. 64-76.
47. *Макушина Н.В., Долотов И.И., Пылев С.С.* Анализ дефектов паяных соединений // *Технологии инженерных и информационных систем.* 2023. № 2. С. 68-87.
48. Единая система конструкторской документации: Справочное пособие. — М.: Издательство стандартов, 1989.
49. Единая система технологической документации: Справочное пособие. — М.: Издательство стандартов, 1992.
50. Правила оформления конструкторской документации электронной аппаратуры. Методические указания к дипломному проектированию / А.В. Еланцев и др. В 2-х ч. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 1994.